



RE470

- Epoxyd FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au mit Lötstopmmaske beschichtet
- Pitch 0,40 mm (15,7 mil) und 0,50 mm (19,7mil)
- Adaptionsplatine für 23 verschiedene SMD-QFPs
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Vorgeritzte Sollbruchstellen zum Trennen einzelner Module von der Platine
- Gerberdaten zur Herstellung der Lötstopmmaske und des Lötpastenaufdrucks werden auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt
- Größe 132,00 x 203,00 mm

Modul-Nr.	Pitch	Pin	mil	Größe (mm)
RE470-01	S 0,500 mm	QFP 40, 48	19,7	7,00 x 7,00
	S 0,400 mm	QFP 80	15,7	10,00 x 10,00
RE470-02	S 0,500 mm	QFP 80	19,7	12,00 x 12,00
	S 0,400 mm	QFP 100, 108	15,7	12,00 x 12,00
RE470-03	R 0,500 mm	QFP 120, 128	19,7	14,00 x 20,00
	R 0,400 mm	QFP 100, 108	15,7	10,00 x 14,00
RE470-04	S 0,500 mm	QFP 72, 100	19,7	10,00 x 10,00
	S 0,400 mm	QFP 12	15,7	14,00 x 14,00
RE470-05	S 0,500 mm	QFP 144, 176	19,7	20,00 x 20,00, 24,00 x 24,00
	S 0,400 mm	QFP 184	15,7	20,00 x 20,00
RE470-06	R 0,500 mm	QFP 256, 264	19,7	28,00 x 40,00
	R 0,400 mm	QFP 224, 232	15,7	20,00 x 28,00
RE470-07	S 0,500 mm	QFP 208, 240	19,7	28,00 x 28,00, 32,00 x 32,00
	S 0,400 mm	QFP 264	15,7	28,00 x 28,00